

ADVANTEST®

2023年度（2024年3月期） 第1四半期決算説明会

2023年7月26日
株式会社アドバンテスト

All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION

ご注意

会計基準について

- 本プレゼンテーション資料に記載されている実績や見通し数値は、国際会計基準（IFRS）に基づいて作成しています。

将来の事象に係る記述に関する注意

- 本プレゼンテーション資料およびアドバンテスト代表者が口頭にて提供する情報には、将来の事象についての、当社の現時点における期待、見積りおよび予測に基づく記述が含まれております。これらの将来の事象に係る記述は、当社における実際の財務状況や活動状況が、当該将来の事象に係る記述によって明示されているものまたは暗示されているものと重要な差異を生じるかもしれないという既知および未知のリスク、不確実性その他の要因が内包されており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。

本資料の利用について

- 本プレゼンテーション資料に記載されている情報は、各国の著作権法、特許法、商標法、意匠法等の知的財産権法その他の法律及び各種条約で保護されています。事前に当社の文書による承諾を得ない限り、法律によって明示的に認められる範囲を超えて、これらの情報を使用（改変、複製、転用等）することを禁止します。



2023年度第1四半期決算報告

経営執行役員

CFO(Chief Financial Officer) & CSO(Chief Strategy Officer)

経営戦略本部長 三橋 靖夫

All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION

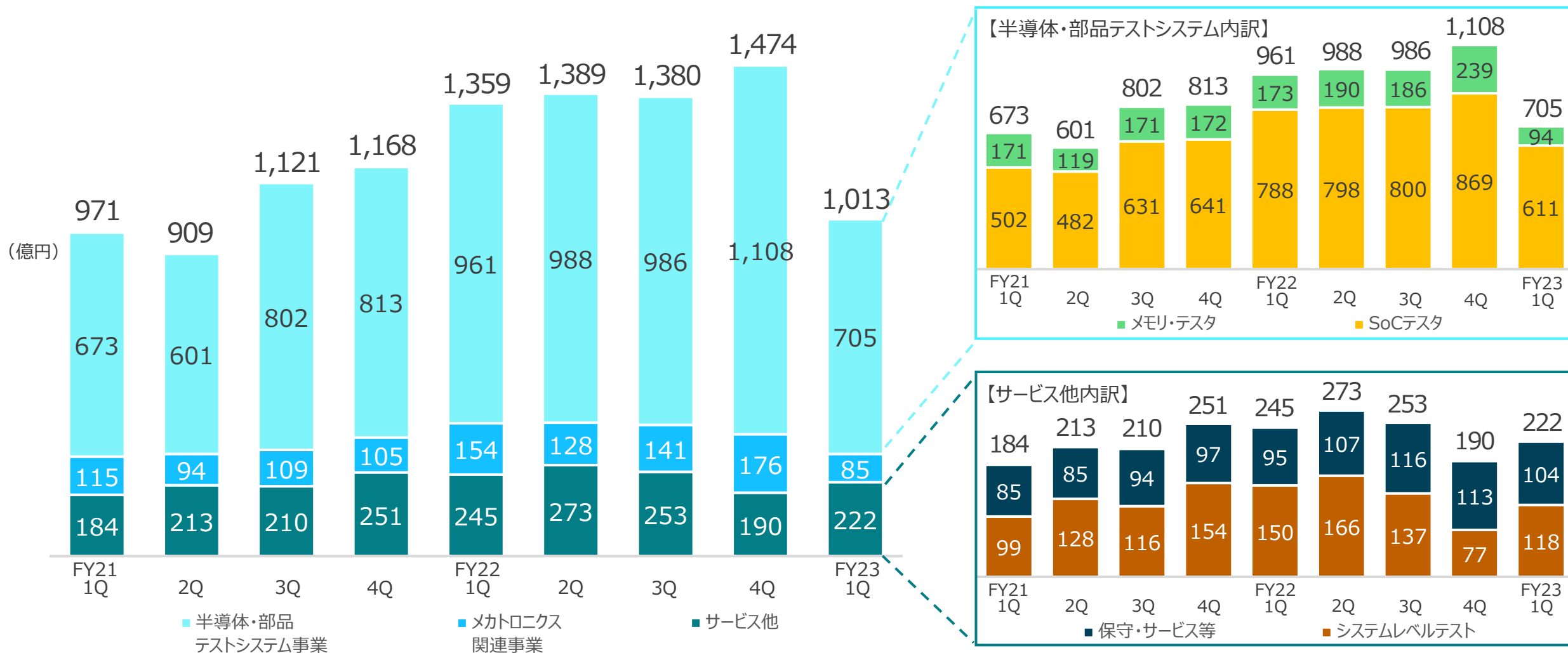
ADVANTEST[®]

四半期業績推移

(億円)

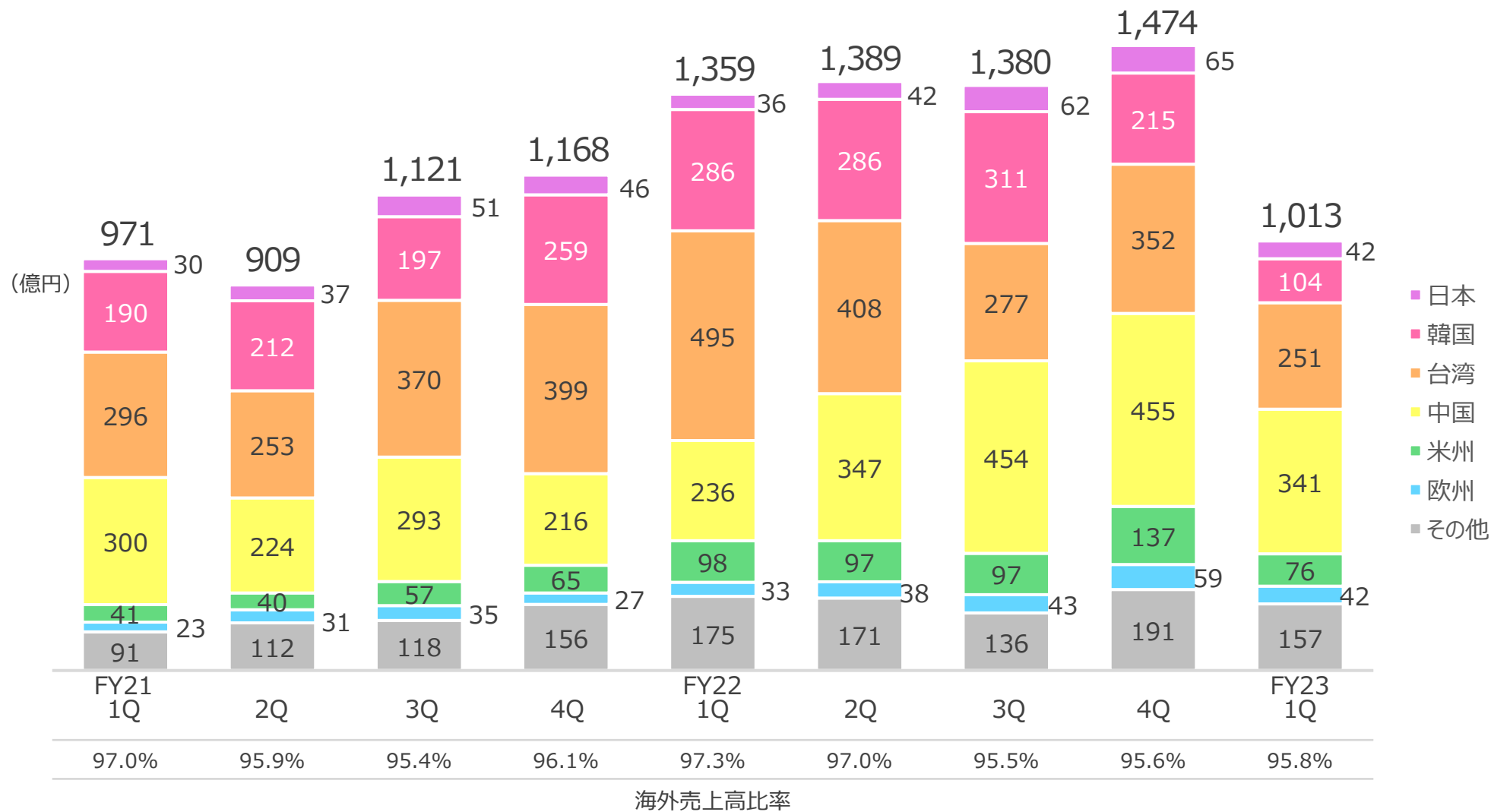
	FY22				FY23				
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	前期比		前年同期比	
						増減額	増減率	増減額	増減率
売上高	1,359	1,389	1,380	1,474	1,013	-461	-31.3%	-347	-25.5%
売上総利益	789	799	816	787	510	-277	-35.3%	-280	-35.4%
売上総利益率	58.1%	57.5%	59.1%	53.4%	50.3%	-3.1pts		-7.8pts	
営業利益	448	431	412	386	143	-243	-63.0%	-305	-68.1%
営業利益率	32.9%	31.1%	29.9%	26.2%	14.1%	-12.1pts		-18.8pts	
税引前四半期利益	484	468	377	384	130	-255	-66.3%	-355	-73.2%
四半期利益	365	347	286	306	92	-214	-69.9%	-273	-74.8%
四半期利益率	26.8%	25.0%	20.8%	20.8%	9.1%	-11.7pts		-17.7pts	
為替レート	1米ドル	124円	135円	144円	133円	135円	2円 円安		11円 円安
	1ユーロ	134円	139円	144円	142円	146円	4円 円安		12円 円安

四半期売上高 事業セグメント別

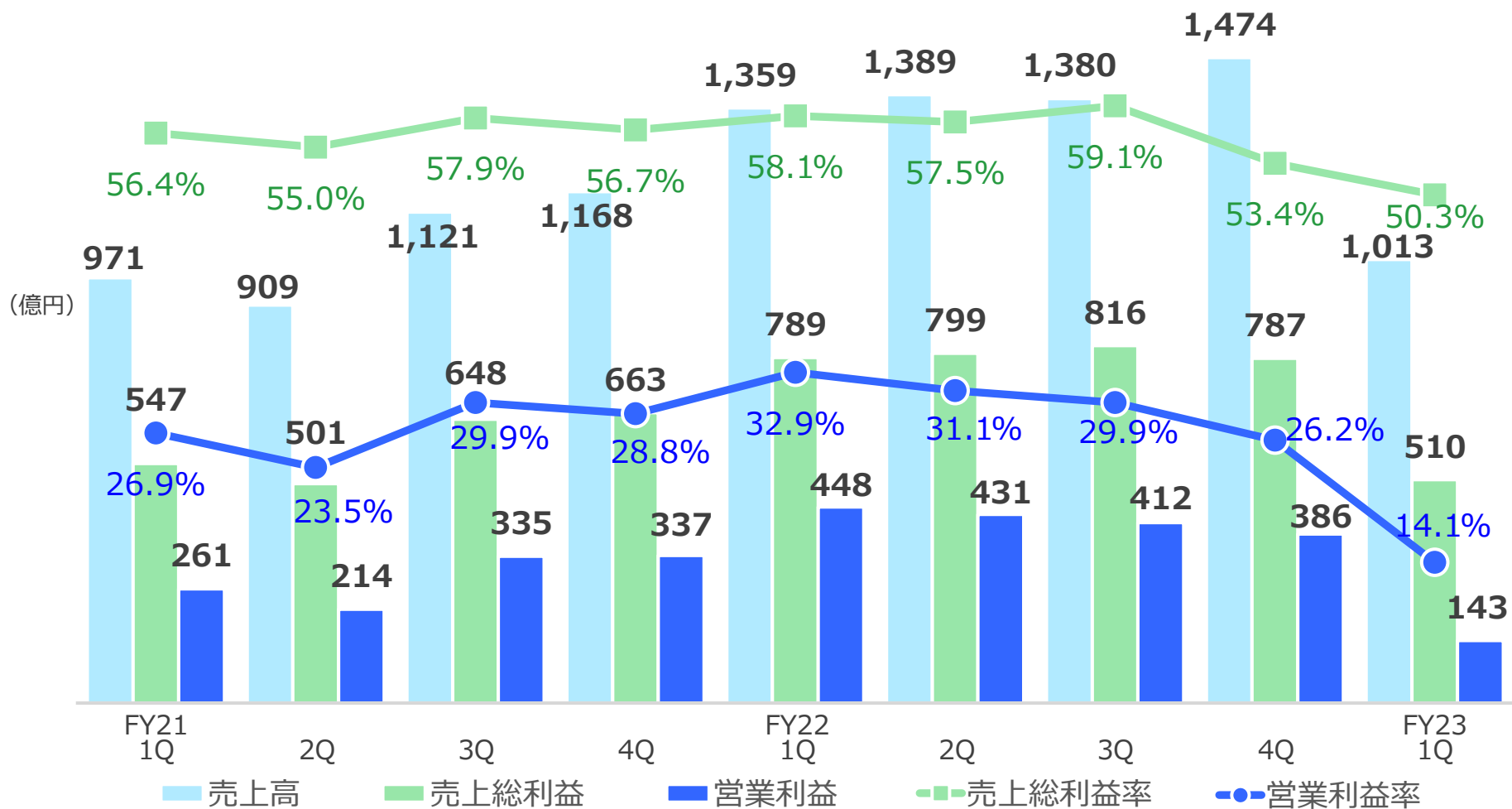


*合計にはセグメント間の内部取引の消去分が含まれます

四半期売上高 地域(出荷先)別



売上高/売上総利益/営業利益

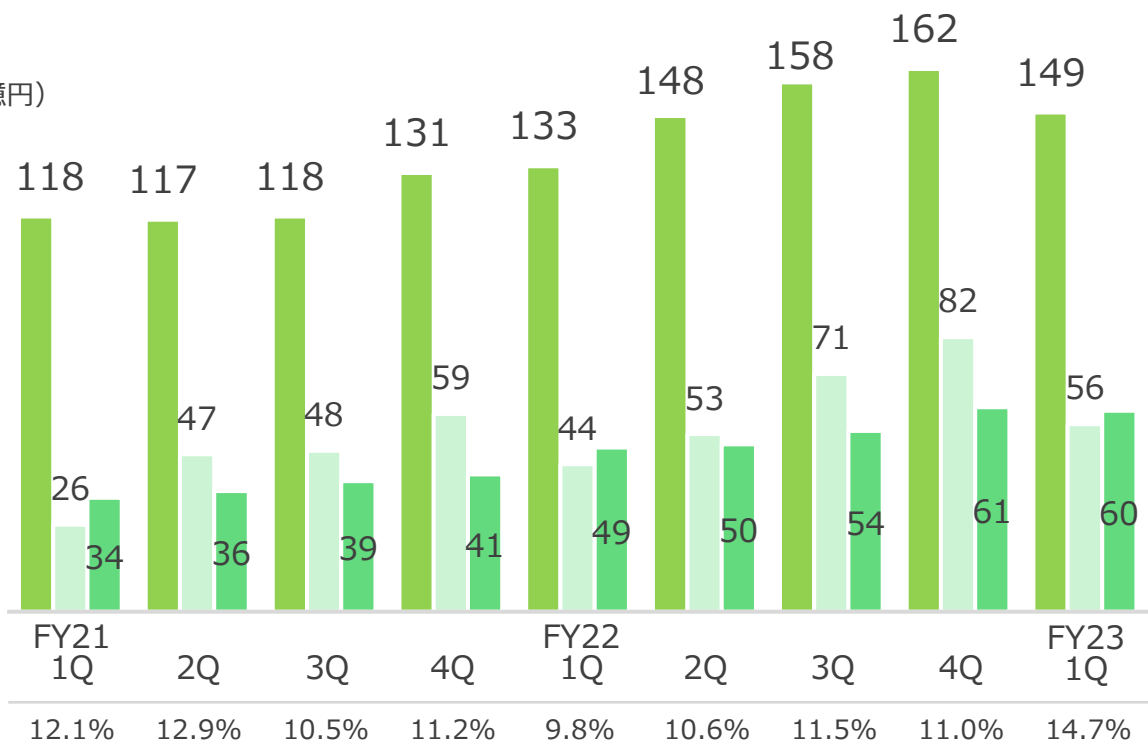


投資等/キャッシュ・フロー

<投資等>

- 研究開発費
- 設備投資
- 減価償却費

(億円)

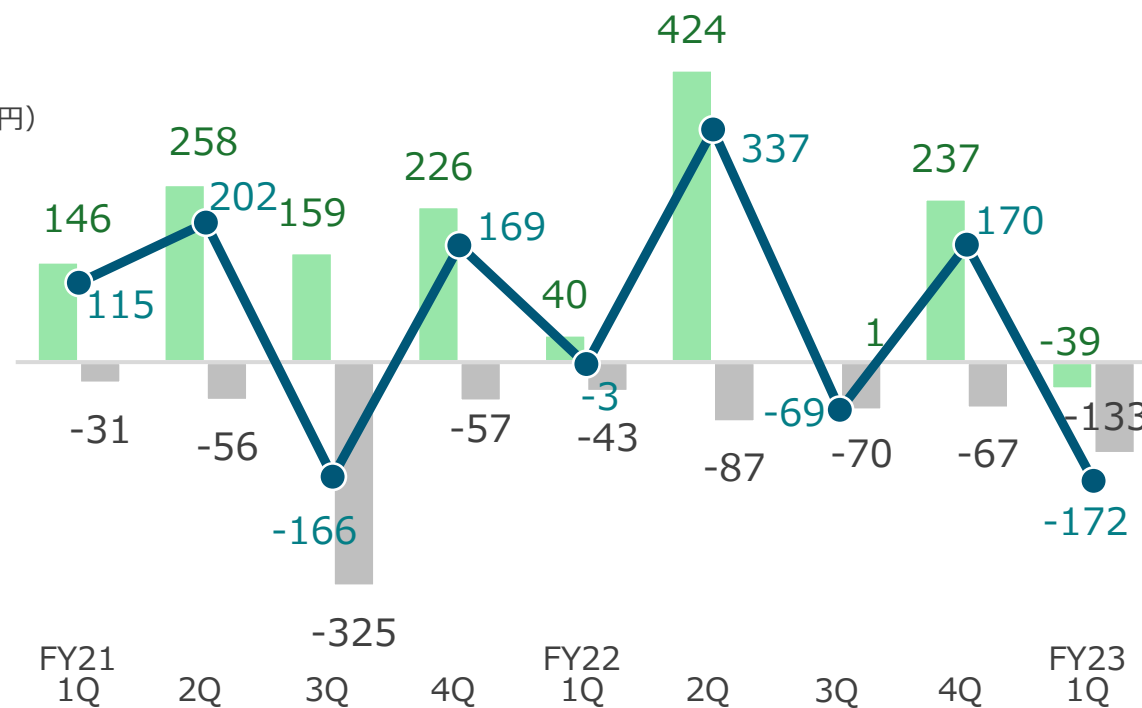


研究開発費売上高比率

<キャッシュ・フロー>

- 営業キャッシュ・フロー
- 投資キャッシュ・フロー
- フリー・キャッシュ・フロー

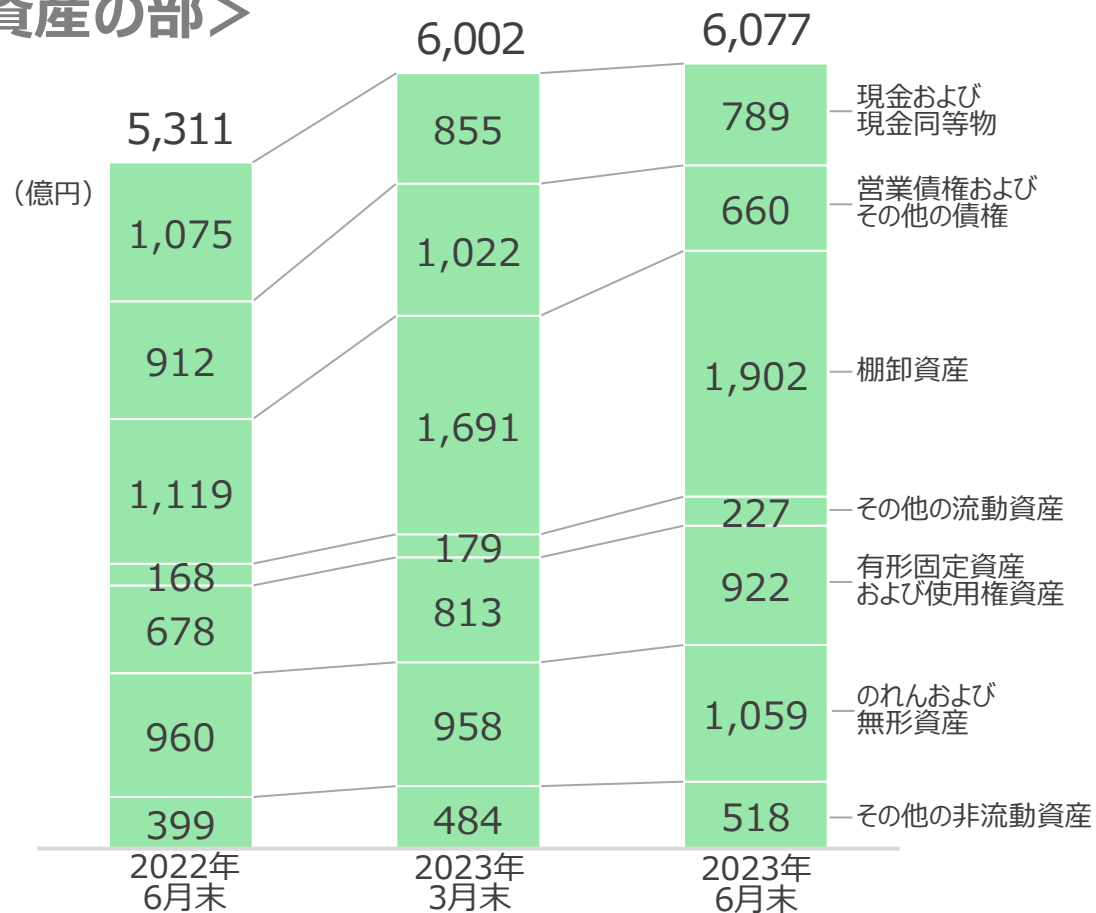
(億円)



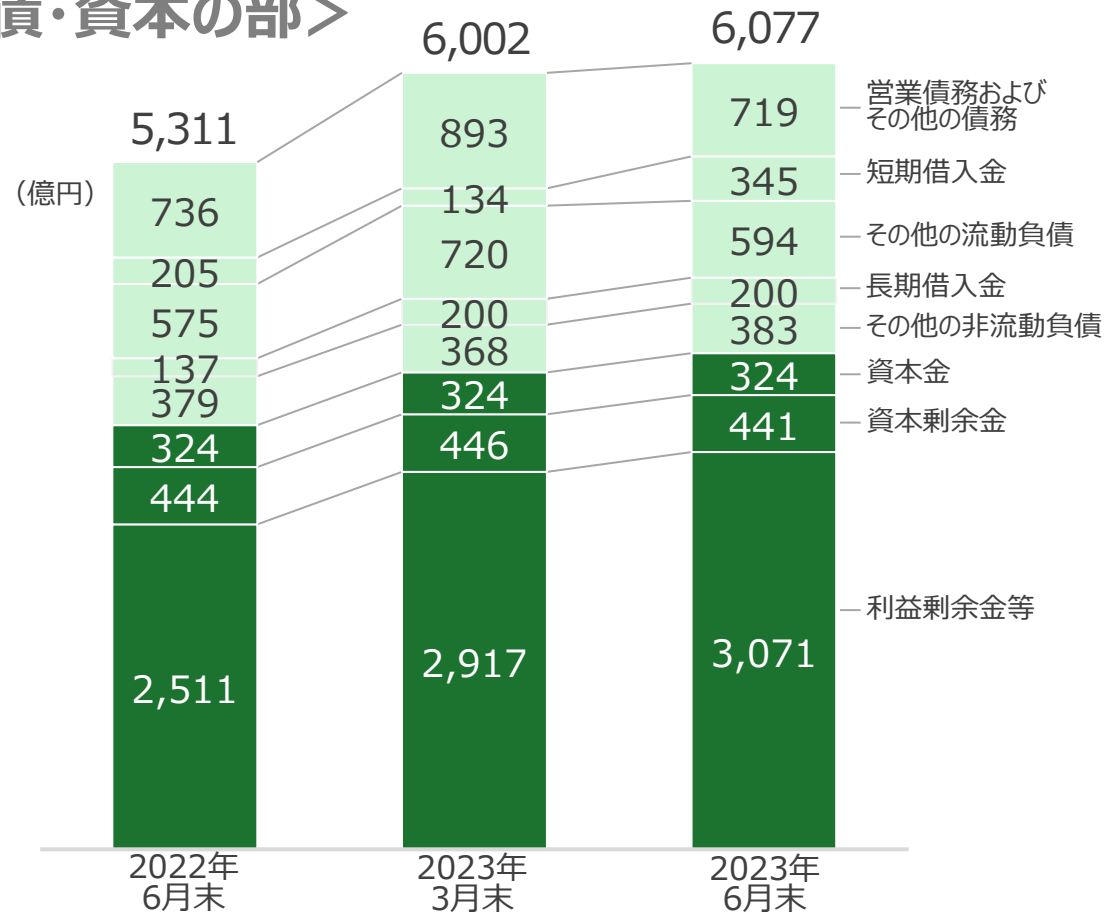
*フリー・キャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー

連結財政状態

<資産の部>



<負債・資本の部>



親会社の所有者に 帰属する持分	3,279	3,687	3,836
親会社所有者 帰属持分比率	61.7%	61.4%	63.1%

2023年度事業見通し

代表取締役 兼 執行役員社長 Group CEO 吉田 芳明

事業環境と半導体テスト市場の動向 <23年7月時点の見方>

<事業環境：不確実性の高い状況が継続>

– インフレ進行や金利上昇などによる景気後退、地政学的リスクの拡大や急速な為替変動リスクなど不確実性が高い状況が継続

<半導体市場：主要民生機器向け需要の低迷が続く>

– 自動車や産業機器向けなどの一部の半導体需要は堅調なもの、スマートフォンなど主要民生機器向けでの半導体需要減退に加え、データセンタ投資も減速したことから、関連する半導体メーカーでの生産調整は当面継続するものと見込む

<半導体テスト市場：2年連続で規模縮小を見込む>

– 高性能半導体向けのテスト量は増加しているものの、顧客サプライチェーンに設備の余剰もあり、テスト需要の回復は期初の想定よりも緩やかになると予想

	CY22実績	CY23推定	CY23推定 4月時点推定との差
SoCテスト市場	約\$4.0B	約\$3.2B-3.5B (4月時点推定: 約\$3.4B - 3.8B)	スマートフォン関連向け中心に 市場規模引き下げ
メモリ・テスト市場	約\$1.2B	約\$0.9B-1.1B (4月時点推定: 約\$0.9B - 1.1B)	—

Source: Advantest

FY23業績予想

(億円)

	FY22	FY23							(参考)新旧予想比較	
	実績			上期予想	下期予想	通期予想	前年度比		4月時点 FY23予想	修正額
		1Q実績	2Q予想				増減額	増減率		
売上高*1	5,602	1,013	1,127	2,140	2,660	4,800	-802	-14.3%	4,800	-
営業利益	1,677	143	223	366	684	1,050	-627	-37.4%	1,050	-
営業利益率	29.9%	14.1%	19.8%	17.1%	25.7%	21.9%	-8.0pts		21.9%	-
税引前利益	1,713	130	222	352	683	1,035	-678	-39.6%	1,035	-
当期利益	1,304	92	168	260	520	780	-524	-40.2%	780	-
当期利益率	23.3%	9.1%	14.9%	12.1%	19.5%	16.3%	-7.0pts		16.3%	-
研究開発費	601	149	161	310	320	630	+29	+4.8%	630	-
設備投資	250	56	52	108	102	210	-40	-16.0%	210	-
減価償却費	214	60	58	118	122	240	+26	+12.1%	230	+10
為替レート*2	1米ドル	134円	135円	135円	135円	135円	135円	1円 円安	130円	5円 円安
	1ユーロ	140円	146円	150円	148円	150円	149円	9円 円安	140円	9円 円安

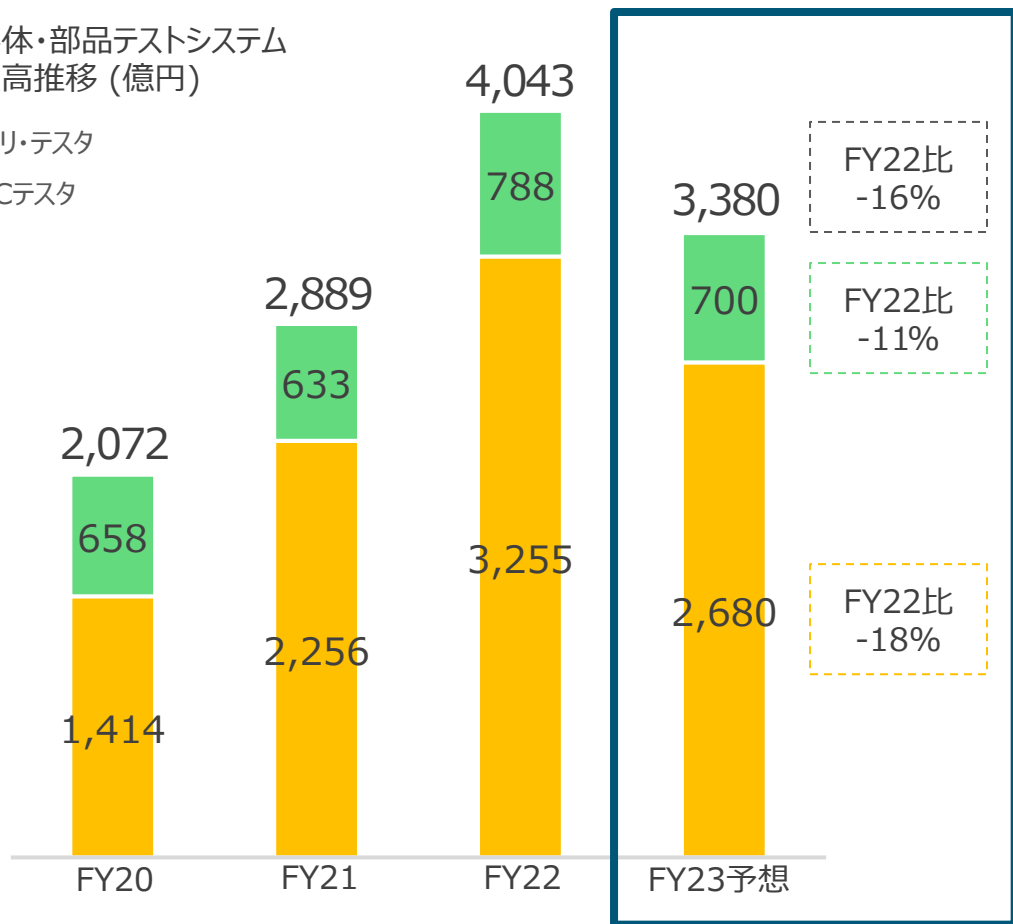
*1:合計にはセグメント間の内部取引の消去分が含まれます

*2:為替レート変動が今年度の営業利益に与える影響の最新見通しは、対米ドルが1円安時+11億円です。対ユーロは-3億円です

FY23見通し（事業別）

半導体・部品テストシステム
売上高推移（億円）

■ メモリ・テスト
■ SoCテスト



半導体・部品テストシステム事業

<SoCテスト>（4月予想比 +30億円）

– 車載・産業機器向けは比較的堅調なものの、スマートフォンの市況弱含みを背景に先端プロセス品向けでの需要の落ち込みを想定

アプリケーション別内訳	FY20	FY21	FY22	FY23(予)
コンピューティング・通信	55%	60%	65%	60%
車載・産業機器・民生・DDIC*	45%	40%	35%	40%

内訳比率は実数ではなく、5%近似値で丸めて表示しています

<メモリ・テスト>（4月予想から変更なし）

– 高性能メモリ向けでは需要増を見込む一方、民生向けメモリの市況悪化を受け減収見通し

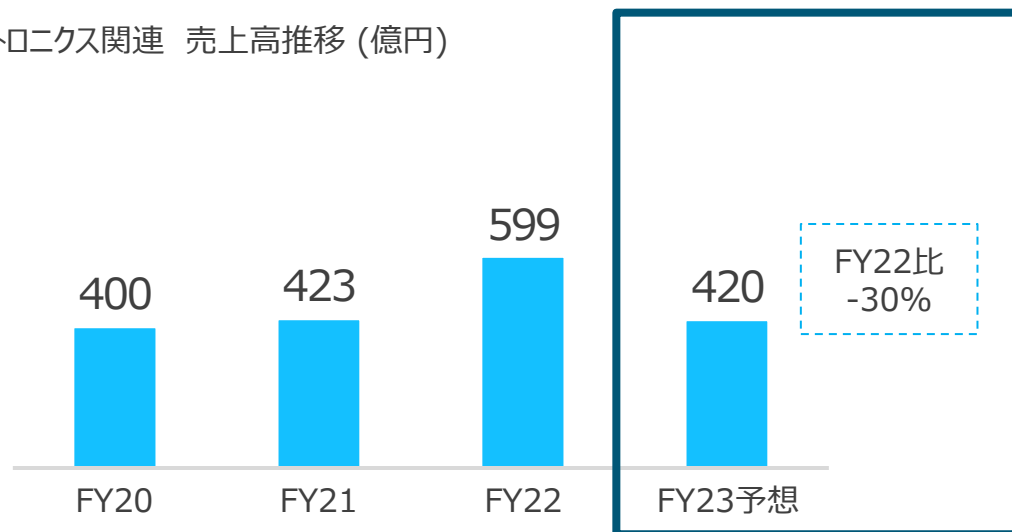
アプリケーション別内訳	FY20	FY21	FY22	FY23(予)
DRAM	60%	60%	60%	80%
不揮発性メモリ	40%	40%	40%	20%

内訳比率は実数ではなく、5%近似値で丸めて表示しています

* DDIC:ディスプレイ・ドライバーIC

FY23見通し（事業別）

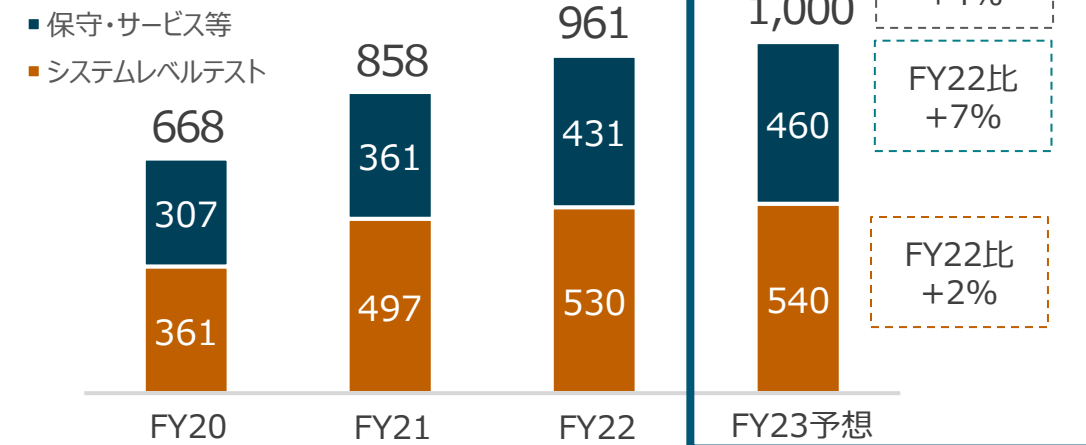
メカトロニクス関連 売上高推移（億円）



メカトロニクス関連事業（4月予想比 -30億円）

– テスタ投資減速に伴い、デバイス・インタフェース製品やテスト・ハンドラは減収を予想

サービス他 売上高推移（億円）

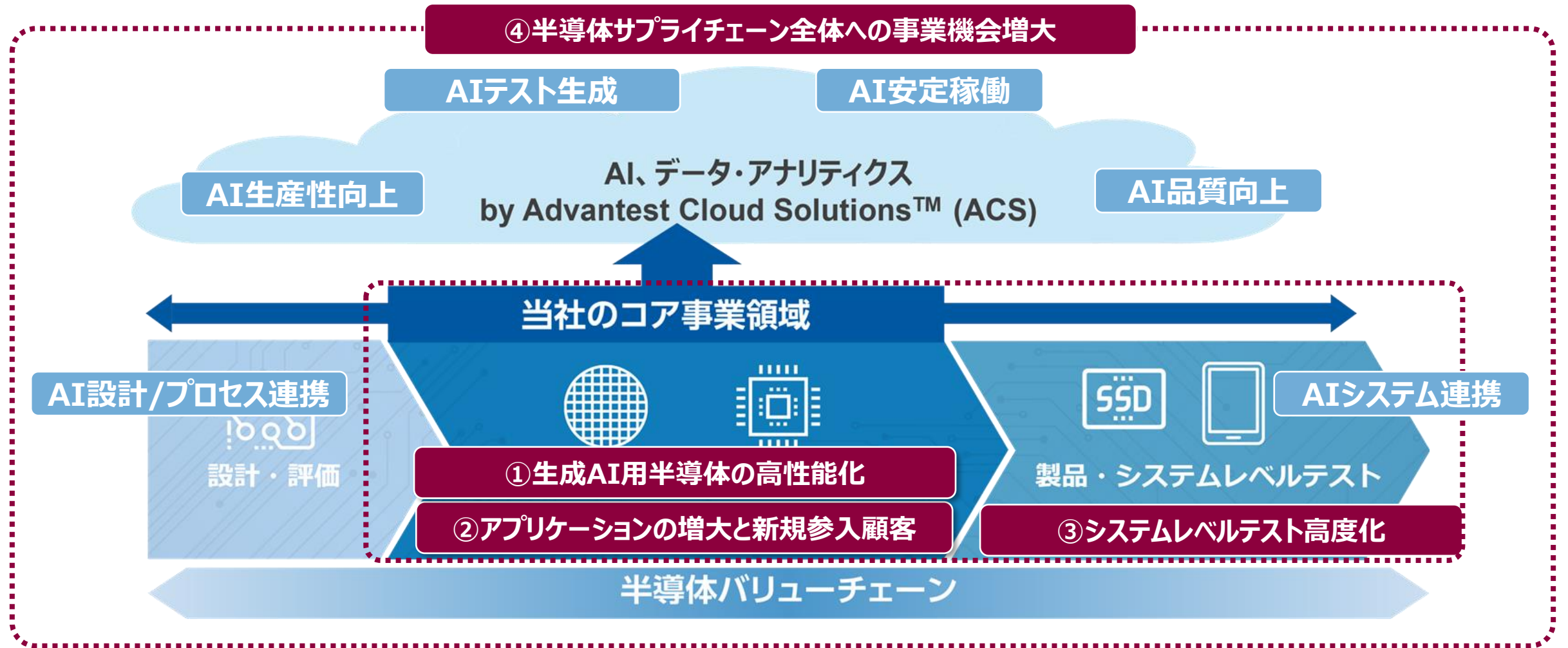


サービス他事業（4月予想から変更なし）

– 当社製品の設置台数の着実な伸びにより、保守サービスの需要は堅調

– システムレベルテスト事業は民生機器関連での市況低迷の影響を受けているが、前年度並みの売上を見込む

生成AIがもたらす当社の事業機会①



生成AIがもたらす当社の事業機会②

- **生成AIに必要となる高性能デバイスの試験に最適な製品ポートフォリオ**
 - GPUやCPU、さらにはHBMなどの高性能メモリといった、複雑で高性能な生成AI用デバイス試験に必要なSoCおよびメモリデバイス向けテストプラットフォームをすべて保有
 - 2.5D、3Dなどの先端パッケージ採用が需要をけん引するシステムレベルテストの技術を保有
- **AI/HPC市場における強固な顧客基盤**
 - 既存AI/HPC関連顧客のサプライチェーン全体との確立されたパートナーシップ
 - 生成AIの社会実装に向け、多様な新規市場参入者と協業開始
- **半導体産業でのTime to Market、Time to Quality、Time to VolumeにAIを活用したデータ・プラットフォームサービスを提供**
 - Advantest Cloud Solutions™を通じたデータ・アナリティクスサービスを顧客とともに開発中

サマリー

- **事業環境の不確実性は高い状況が継続**
 - － インフレ進行、金利上昇、為替変動、米国による対中国輸出規制、地政学的リスクなど世界経済への下押し圧力継続
- **半導体テスト市場の需要はアプリケーションごとにまだら模様**
 - － 高性能SoC半導体用のテスト需要は上向くも、テスト設備の余剰消化にはなお時間を要する
 - － 車載向けSoC半導体用および高性能メモリ半導体用のテスト需要は底堅く推移
- **通期業績予想達成に邁進するとともに、中長期的な需要の波に備え、主要施策を実行**
 - － 生成AI技術の社会実装はこれから。半導体サプライチェーン上で当社の事業機会最大化のための投資を継続
 - － 経営判断の更なるスピード向上のためCxO体制見直しと事業プロセスの見直し

- TechInsights社顧客満足度調査にて
4年連続第1位を獲得

※当社プレスリリース：<https://www.advantest.com/ja/news/2023/20230522.html>



- アドバンテスト、NXP Semiconductors社、
アリゾナ州立大学が共同で初のテスト・エン
ジニアリング・コースを開始

※当社プレスリリース：<https://www.advantest.com/ja/news/2023/20230621.html>



※新しいコースのために開発したテスト回路を確認する様子

ADVANTEST®